

锦州神工半导体股份有限公司

关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、公司增加注册资本的相关情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2051号），公司已完成向特定对象发行股票相关工作。公司已于2023年9月15日收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2023]110Z0012号），确认本次发行后，公司注册资本由人民币160,000,000.00元增加至人民币170,305,736.00元，总股本由160,000,000股增加至170,305,736股。本次公司2023年度向特定对象发行股票新增股份10,305,736股已于2023年10月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记。

二、《公司章程》部分条款修订情况

鉴于前述增加注册资本的基本情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司将对《锦州神工半导体股份有限公司章程》的相关条款进行修订，具体修改内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币16,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 170,305,736.00元 。
第十九条 公司股份总数为 16,000 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 170,305,736股 ，均为普通股。

除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。根据公司2022年年度股东大会审议结果，本次《公司章程》的修订事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。上述变更尚需经工商行政主管部门办理变更登记，董事会授权管理层或其指定人员办理上述事宜并签署相关文件。

上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日